



上場会社名



株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号

7729

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.accrettech.jp/>)

代表者 代表取締役社長 C.E.O.兼 C.O.O. 鈴木 貞勝

問合せ先責任者 代表取締役業務会社執行役員社長 太田 邦正

TEL (0422) 48 - 1011

決算取締役会開催日 平成 18年 5月 17日

米国会計基準採用の有無 無

1. 18年 3月期の連結業績(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18年 3月 31日)

(1)連結経営成績

(金額:百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年 3月期	92,845	9.6	13,991	7.2	14,031	8.9
17年 3月期	84,750	36.0	13,051	119.4	12,885	141.8

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
18年 3月期	3,125	29.9	80 77	74 02	74 02	7.8	13.3	15.1
17年 3月期	4,459	-	118 82	108 75	108 75	14.3	13.2	15.2

(注) 持分法投資損益 18年 3月期 - 百万円 17年 3月期 - 百万円
 期中平均株式数(連結) 18年 3月期 38,515,065 株 17年 3月期 37,452,407 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年 3月期	109,875	46,703	42.5	1,165 07
17年 3月期	100,993	33,003	32.7	879 93

(注)期末発行済株式数(連結) 18年 3月期 40,073,746 株 17年 3月期 37,495,725 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年 3月期	8,346	6,160	290	13,851
17年 3月期	7,058	1,769	5,732	11,838

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 7 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0 社(除外) 1 社 持分法(新規) 0 社(除外) 0 社

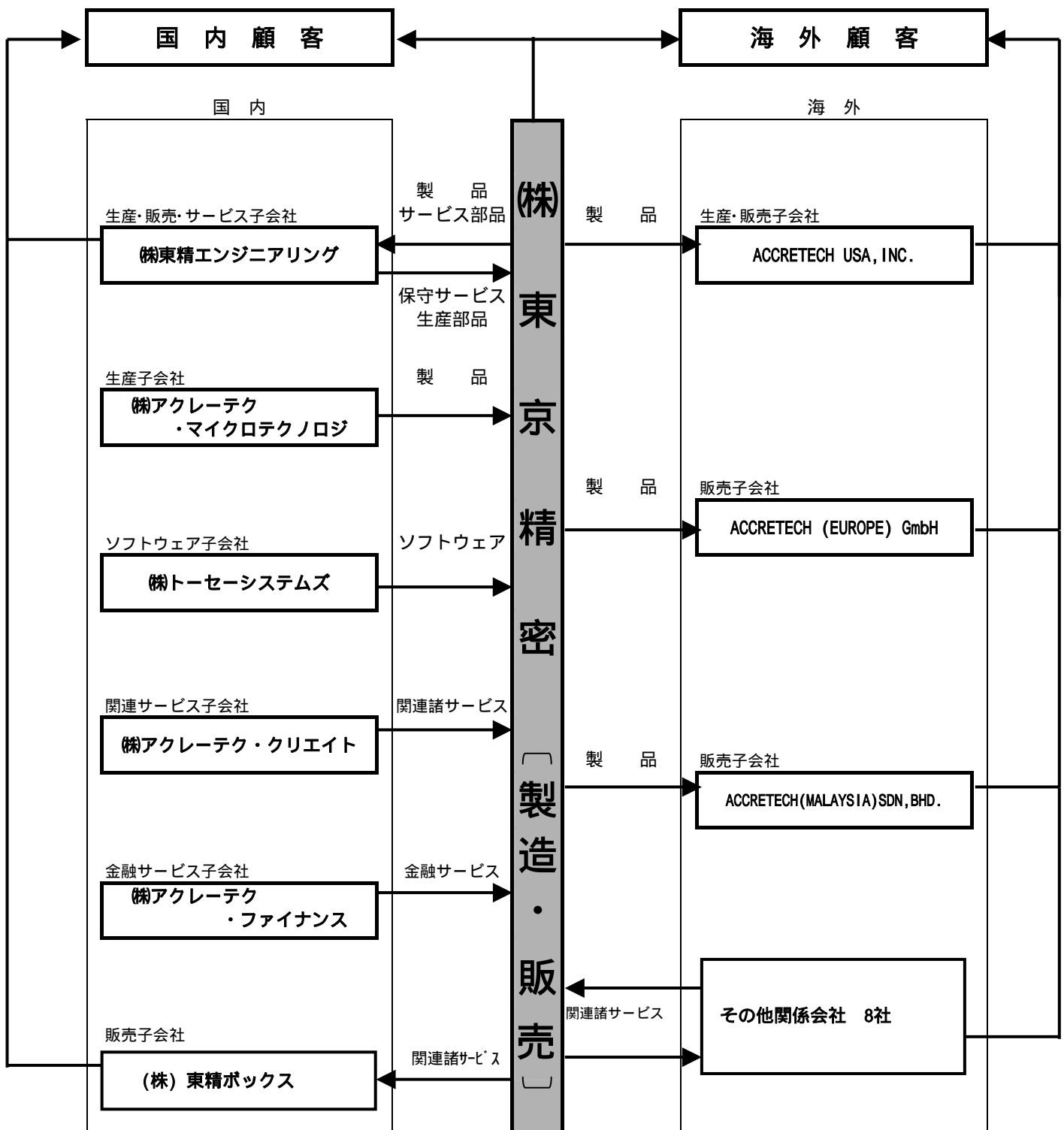
2. 19年 3月期の連結業績予想(平成 18年 4月 1日 ~ 平成 19年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	51,000	9,000	5,000
通期	102,000	18,000	10,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 249円 54銭

上記の予想は、7~9頁に記載した事項等を前提としています。

1. 企業集団の状況



2. 経営方針

(1) 基本方針

当社は、計測機器および半導体製造装置メーカーとして、お客様の生産性向上に寄与する最先端の製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めております。

「製品開発の原則」

世界 No.1 の製品を創る

マーケットシェア No.1 の商品は、

(a) 好況時の利益の極大化がはかれる

(b) 不況時の損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う

相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する

当社は、「WIN - WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を行動指針として制定しております。当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ国内外の会社および個人と“WIN - WIN”の関係を築くことにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

また、当社は、経営体制として、半導体社、計測社、業務会社の三つの社内カンパニー制と執行役員制を採用しています。各カンパニーは、完結した組織として責任と権限を有し、夫々のお客様に機動的かつ迅速に対応することにより、顧客満足の向上と業績拡大を目指します。

開発体制は、各技術開発グループを製品別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採っています。各グループリーダーは執行役員に選任されており、製品開発のみならず、担当する製品の業績責任を負い、事業計画作成、設備投資および人材の採用など大きな権限を与えられています。

さらに、半導体社では、半導体製造工程別のプロダクトセールス部門および顧客別・地域別セールス組織が、製品別の技術開発グループにクロスファンクショナルな形で関わる組織になっており、両者が一体となって、顧客ニーズの早期把握、スピーディな製品開発および市場動向への迅速・柔軟な対応を図ります。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えております。

配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視しつつ、連結当期純利益に対する配当性向 20%を目途に実施していく考えです。

なお、2006 年 5 月 1 日より施行された新会社法の施行後の当社の配当方針に関しましては、2006 年 6 月下旬開催予定の当社定時株主総会において、会社法第 459 条第 1 項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができるよう定款の変更を付議する予定ですが、現時点では従来どおりの中間期末日、期末日を基準とした年 2 回の配当を継続する予定です。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

(3) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

(4) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、2006年4月に、創立60周年となる2009年3月期までの中期計画「AA60(ACCURETECH Action 60)」をスタートさせました。2009年3月期の目標数字は、半導体製造装置部門の連結売上高1,000億円、計測機器部門の連結売上高250億円、全体の営業利益率25%です。製品グループ毎に、数値目標、達成のための製品戦略および具体的な取組み内容は明確になっており、それらの着実な遂行により中期計画の達成を図ってまいります。

近年、お客様から短納期や高品質への要望がますます強くなっています。当社は、2005年3月に計測(土浦工場)半導体(八王子工場)の新工場を完成させ、生産性の向上を図りました。中期計画「AA60」では、さらに品質の向上と生産革新を推進し、リードタイムの短縮やコストダウンを実現していきます。

新会社法の施行にともない、企業のコーポレートガバナンスがより重要となっています。当社は、実効性ある内部統制システムの構築とコンプライアンス体制の確立により、コーポレートガバナンスを強化し、経営の健全性と透明性を確保していきます。

(5) 会社の対処すべき課題

新製品事業の成功

当社は、ここ数年来、半導体新規参入製品の開発を積極的に進めてきました。新規参入製品の中で、「ポリッシュ・グラインダ」は、計画通りの利益を上げていますが、「ウェーハ外観検査装置」と「CMP装置」につきましては、顧客開拓が進んでいるものの、まだ利益面で課題を残しています。今後、「ウェーハ外観検査装置」と「CMP装置」につきましても、売上拡大とコストダウンにより、利益率を計画ラインまで向上させていくように注力いたします。

財務構成の改善

当社の財務構成は、半導体旧機種やリーブル関連資産の処分等により、格段に改善されました。新しい中期計画「AA60」の推進による、売上・利益の拡大、フリーキャッシュフローのプラスおよび転換社債型新株予約権付社債の資本への転換などにより、財務諸比率のさらなる向上を図ります。

(6) 親会社等に関する事項

当社は、当期末現在親会社等を有しておりません。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当期の概況

[業績全般]

当期の当社をとりまく経営環境は、半導体製造装置部門、計測機器部門とも非常に良好でありました。半導体業界は、薄型テレビ・携帯音楽プレーヤーなどのデジタル・コンシューマー機器の需要増やパソコンの好調などにより、半導体メーカーの設備投資は旺盛で、製造装置に対する需要も伸長しました。これを反映して、当社半導体製造装置部門は、過去最高の売上高を達成しました。

計測機器部門につきましても、自動車関連産業や工作機械産業を中心に各ユーザーの需要が増加し、過去最高の売上高と営業利益を計上しました。

この結果、当期の連結受注高は995億58百万円（前期比19.3%増）、連結売上高は928億45百万円（同9.6%増）、連結経常利益は140億31百万円（同8.9%増）となり、連結売上高は2年連続既往ピーク更新となりました。また、連結当期純利益は、特別損失の計上により31億25百万円（同29.9%減）となりました。

[各部門の概況]

A. 半導体製造装置部門

半導体製造装置部門につきましては、期の初めに小さな調整があったものの、全般的には市況は極めて好調裡に推移しました。ニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、当期の連結受注高は、778億74百万円（前期比19.4%増）、連結売上高は、718億24百万円（同7.7%増）となり、ともに既往ピークを更新しました。

連結営業利益も、売上増加とコストダウン推進が寄与し、89億72百万円（同2.1%増）となり、前期比増益を達成しました。

(地域別の状況)

海外、国内とも売上高は前期比大幅に伸びました。海外では東アジア地区が好調で、特に韓国・中国向けが大きく伸長しました。

(製品別の状況)

(a) ウェーハプロ - ビングマシンにつきましては、デバイス需要の好調とウェーハでのフルテストの必要性の高まりなどを背景に、市況は極めて活発でした。

300mm対応の「UF3000」は、フラッシュメモリーをはじめとする各デバイス向けに、前期比大きく伸びました。「UF3000」は、300mm対応の第三世代機で、システムLSIなどの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まで、あらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プロービングマシンとして、お客様から高い支持を得ています。

また、台湾向けなどに、200mm対応機の「UF200」シリーズも堅調に推移しています。当社は、ウェーハプロービングマシンのNo.1プレーヤーとして、当期は世界的にシェアをさらに拡大して、2000年度を上回る過去最高の売上高を達成し、当社業績の柱となっています。

(b) ウェーハダイシングマシンにつきましても、「A - WD - 300T」および「A - WD - 200T」が、お客様より高い評判を得て、堅調に推移しました。さらに、2006年4月には、8万回転のスピンダルを備え、高い生産性を有する300mm対応の新製品「A - WD - 300TX」を市場投入しましたので、今後一層の売上拡大が見込まれます。

また、2004年度より販売開始した、ブレードを使わない完全ドライブプロセスの新型レーザダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」は、ユーザーから性能および生産性を高く評価されており、当期の販売は、MEMS向けや薄物ウェーハ向けに前期比倍増となりました。リピートオーダーも増加しており、今後の拡販が期待されます。

(c) ウェーハ外観検査装置では、「WIN - WIN50」の強みである、低いCost of Ownershipや高い検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーを頂くとともに、新規ユーザーも増えています。また、新たに高いスループットのシリーズを加えて、多岐にわたるユーザーニーズに対応しております。

2006年度初めに、広いアプリケーションと量産性に優れた新製品の市場投入を予定しており、さらなる業績拡大を目指します。

(d) ポリッシュ・グラインダは、ウェーハの薄片化とダメージ除去を1台で実現している他に追従を許さない当社独自の製品で、ウェーハ薄片化市場におけるデファクトスタンダードとなりました。当期は、300mm対応機である「PG300RM」の需要が急拡大し、受注・売上とも前期比大幅に増え、過去最高となりました。薄物ウェーハのニーズは、引き続き増加していくと考えられ、ポリッシュ・グラインダの成長性は高いと予想しています。

(e) CMP装置につきましても、当社の「ChaMP」シリーズのコンセプトや構造の優位性がお客様に浸透し、新規ユーザーの獲得に向けて、性能評価が順調に進んでいます。Cuのみならず、酸化膜でのアプリケーションへの展開もあり、今後の期待されます。

B. 計測機器部門

計測機器部門につきましては、好調が続く自動車業界や工作機械業界などのユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、売上が大幅に拡大しました。当期の連結受注高は216億83百万円（前期比19.1%増）、連結売上高は210億20百万円（同16.3%増）となり、ともに過去最高となりました。受注高・売上高とも、2003年度以降、3期連続既往ピークを更新しています。

生産面でもコストダウンに注力し、当期の連結営業利益は、50億19百万円（同17.6%増）となりました。連結営業利益も3期連続過去最高を更新中です。

(地域別の状況)

地域別に見ますと、国内が特に大きく伸長しましたが、海外も前期を上回ることができました。

(製品別の状況)

(a) 汎用計測機器のうち、三次元座標測定機につきましては、カールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した「ザイザックスSVA」シリーズが、お客様のニーズに合った製品として好調です。スキャニング高精度保証の「ザイザックスSVA fusion」も順調です。当期に市場投入したカールツァイス社の新製品「ゲージMAX」は、インラインで使用される三次元座標測定機で、今後の伸びが期待されます。

また、リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム」シリーズも、「サーフコム1500DX」や「コンターレコード1700DX」などを中心に堅調に推移しています。

高精度で高評価を得ている真円度測定機「ロンコム」シリーズでは、「ロンコム54/44」や「ロンコム72/75」などがラインアップに加わり、売上が拡大しています。

(b) 自動計測機器につきましても、自動車産業の活発な設備投資を受けて、自動車の部品生産ライン等で使用される「パルコム」シリーズが好調で、売上高は前年比大きく伸びました。

[特別損失について]

当社は、財務体質改善と今後の収益基盤強化の観点より、当期に、特別損失を 62 億 81 百万円計上いたしました。主要内訳は、半導体製品の旧機種についての棚卸廃棄損および評価損約 28 億円と、リープル関連設備の固定資産除却損およびリース解約費用約 32 億円などです。

[利益配分について]

当期の配当につきましては、中間配当として一株当たり 20 円を実施いたしました。期末配当につきましては、特別損失はありましたが、長期的視点で保有していただいている株主の皆様 viewpoint と当社の財務状況を踏まえ、一株当たり 20 円を継続し、一株当たり年間配当で 40 円とすることを第 83 期定時株主総会で提案させていただく予定であります。

次期の見通し

[業績全般及び各部門の概況]

A. 半導体製造装置部門

今後の半導体市場は、携帯電話および薄型テレビなどのデジタル・コンシューマー機器の需要増に加え、パソコンの堅調な需要や車載デバイスの伸長などにより引続き高い重要が見込まれ、半導体メーカーやファウンドリーによる活発な設備投資が期待されます。

このような状況下、当社は、2006 年度の半導体製造装置について、既存製品および新規参入製品とも良好な経営環境にあると考えています。

既存製品のウェーハプロービングマシンは、ウェーハのフルテストニーズの高まりにより市場が拡大するなかで、マーケットシェアも伸び、受注・売上とも前期比大きく伸びると予想しています。また、ウェーハダイシングマシンもレーザーダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」の大幅増と新製品「A-WD-300TX」による売上増が見込まれます。

新規参入製品についても、今期急拡大したポリッシュ・グラインダは、引続き好調な推移が見込まれ、ウェーハ外観検査装置と CMP 装置は、顧客開拓による売上伸張が期待できます。

以上より、半導体製造装置部門の 2006 年度の売上高は、800 億円（前期比 11.4%増）と予想しています。業界水準を上回る伸びが期待でき、2005 年度に続き既往ピーク更新となる見通しです。

B. 計測機器部門

計測機器部門につきましても、2006年度も引続き、自動車関連をはじめ工作機械、ベアリングなどの各ユーザーから強い需要が見込まれ、好調に推移すると考えています。

かかる状況下、お客様のニーズを的確に把握し受注に繋げることにより、2006年度売上高は220億円（前期比4.7%増）と4期連続過去最高を計画しています。

以上のような予測の下、2006年度の連結売上高は1,020億円と、3年連続で既往ピーク更新となるとともに、初めて1,000億円の大台を超えると予想しています。

利益につきましては、通期の連結経常利益は、180億円（同28.3%増）連結当期純利益は100億円（同3.2倍）と共に過去最高を予想しています。

[利益配分について]

期末配当金につきましては、上記業績見通しおよび前述の利益配分に関する基本方針に従い、安定的な配当を継続することとし、一株当たり25円（中間配当金と合わせ通期では、一株当たり10円増配し、一株当たり50円）を予定しております。

(2) 財政状態

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より20億円増加し、138億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは83億円の収入となりました。これは主に税金等調整前利益（78億円）、減価償却費（27億円）、売上債権の増加（40億円）、たな卸資産の減少（11億円）、仕入債務の増加（65億円）および法人税等の支払（32億円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは61億円の支出となりました。これは設備投資支出（48億円）、長期定期性預金の預入（10億円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、2億円の支出となりました。これは主に、短期借入金の増加（25億円）、長期借入金の減少（21億円）および配当金の支払（13億円）などによるものであります。

当期の営業キャッシュ・フローは、83億円のプラスとなりました。今後も売上拡大と利益計上などにより、営業キャッシュ・フローのプラスが見込まれ、より良い財務状況を構築できる見込です。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
自己資本比率 (%)	30.8	32.7	42.5
時価ベースの自己資本比率 (%)	138.6	138.5	256.4
債務償還年数 (年)	7.9	4.4	3.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	15.7	29.4	41.7

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

注 1 . 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

注 2 . 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数により算出しています。

注 3 . 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

4 . 比較連結貸借対照表

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	科 目	前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日現在)
資 産 の 部			負 債 の 部		
流 動 資 産	73,752	81,067	流 動 負 債	34,941	38,099
現金及び預金	11,866	13,887	支払手形及び買掛金	17,809	24,807
受取手形及び売掛金	32,105	36,437	短期借入金	458	3,056
たな卸資産	28,134	27,053	一年以内返済予定 長期借入金	4,160	3,073
未収消費税等	539	791	一年以内償還予定 社債	450	700
繰延税金資産	753	1,447	未払法人税等	2,890	1,193
その他流動資産	412	1,503	賞与引当金	951	865
貸倒引当金	60	53	その他流動負債	8,221	4,403
固 定 資 産	27,240	28,807	固 定 負 債	30,538	25,072
(有形固定資産)	(13,885)	(14,317)	社債	19,400	15,165
建物及び構築物	7,528	7,699	転換社債	51	51
機械装置及び運搬具	1,982	2,273	長期借入金	6,753	5,680
工具器具備品	927	888	退職給付引当金	3,610	3,822
土地	2,917	2,937	役員退職慰労引当金	675	353
建設仮勘定	529	518	繰延税金負債	46	
(無形固定資産)	(2,581)	(4,837)	負 債 合 計	65,479	63,172
ソフトウェア	2,263	1,451			
連結調整勘定		3,161	少数株主持分	2,510	
その他無形固定資産	317	224			
(投資その他の資産)	(10,773)	(9,653)	資 本 の 部		
投資有価証券	3,524	5,786	資 本 金	7,392	9,447
長期貸付金	350	305	資 本 剰 余 金	12,017	20,466
繰延税金資産	6,331	1,907	利 益 剰 余 金	13,596	15,399
その他の投資			その他有価証券評価差額金	70	1,340
その他の資産	578	1,663	為替換算調整勘定	9	139
貸倒引当金	10	9	自 己 株 式	63	90
繰 延 資 産	0		資 本 合 計	33,003	46,703
社債発行差金	0		負 債、少数株主持分 及び資本合計	100,993	109,875
資 産 合 計	100,993	109,875			

5 . 比較連結損益計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	前連結会計年度	当連結会計年度
		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
売上高		84,750	92,845
売上原価		59,344	65,873
売上総利益		25,405	26,971
販売費及び一般管理費		(12,354)	(12,980)
販売費		9,516	9,264
一般管理費		2,837	3,715
営業利益		13,051	13,991
営業外収益		(278)	(875)
受取利息及び受取配当金		51	75
その他の		226	799
営業外費用		(443)	(835)
支払利息		293	272
その他の		150	563
経常利益		12,885	14,031
特別利益		(523)	(116)
投資有価証券売却益		358	76
その他の		165	39
特別損失		(7,007)	(6,281)
たな卸資産評価損及び廃却損		5,861	2,862
固定資産除却損		854	1,387
リース解約費用		59	1,853
その他の		232	178
税金等調整前当期純利益		6,401	7,865
法人税、住民税及び事業税		3,187	1,690
法人税等調整額		1,688	2,851
少数株主利益		444	198
当期純利益		4,459	3,125

6 . 比較連結剰余金計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日		自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		11,806		12,017
資本剰余金増加高				
1. 株式交換による新株式の発行	-		6,218	
2. 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使による新株式の発行	-		1,767	
3. ストックオプションの新株予約権行使による新株式の発行	-		287	
4. 自己株式処分差益	-		175	
5. 新株引受権付社債の新株引受権行使による新株式の発行	211	211	-	8,448
資本剰余金減少高	-	-	-	-
資本剰余金期末残高		12,017		20,466
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		10,273		13,596
利益剰余金増加高				
1. 当期純利益	4,459	4,459	3,125	3,125
利益剰余金減少高				
1. 配当金	1,122		1,312	
2. 取締役賞与	14	1,136	9	1,322
利益剰余金期末残高		13,596		15,399

フ . 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	前連結会計年度	当連結会計年度
		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益		6,401	7,865
減価償却費		2,732	2,768
連結調整勘定償却額		160	171
退職給付引当金の増加額		112	211
役員退職慰労引当金の増減額		118	322
貸倒引当金の増減額		16	8
受取利息及び受取配当金		51	75
支払利息		293	272
有形固定資産除却・売却損		936	1,703
投資有価証券売却益		358	76
子会社株式評価損			60
新株引受権戻入益		150	20
売上債権の増加額		5,427	4,043
たな卸資産の減少額		1,006	1,152
仕入債務の増加額		37	6,546
取締役賞与の支払額		14	9
その他営業活動による収入(支出)		2,685	4,377
小計		8,499	11,817
利息及び配当金の受取額		51	75
利息の支払額		291	284
法人税等の支払額		1,201	3,261
営業活動によるキャッシュ・フロー計		7,058	8,346
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出		21	1,048
定期預金の払出による収入		20	38
投資有価証券の取得による支出		412	263
関係会社への出資による支出		46	40
投資有価証券の売却による収入		579	85
有形固定資産の取得による支出		1,721	4,821
無形固定資産の取得による支出		277	242
有形固定資産の売却による収入		78	87
貸付金の実行による支出		382	
貸付金の回収による収入		413	44
投資活動によるキャッシュ・フロー計		1,769	6,160
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金金の増減額		5,085	2,598
長期借入金の実行による収入		5,300	2,500
長期借入金の返済による支出		4,994	4,660
社債の償還による支出		200	450
新株引受権の権利行使による収入		383	
新株予約権の権利行使による収入			646
自己株式の売却収入			495
配当金の支払		1,122	1,312
その他財務活動による収入(支出)		13	108
財務活動によるキャッシュ・フロー計		5,732	290
現金及び現金同等物に係る換算差額		39	117
現金及び現金同等物の増減額		403	2,012
現金及び現金同等物の期首残高		12,242	11,838
現金及び現金同等物の期末残高		11,838	13,851

8 . 連結財務諸表作成の基本となる事項

1 . 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社(7社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)アクレーテク・マイクロテクノロジー、(株)アクレーテク・クリエイト、(株)アクレーテク・ファイナンス、ACCRETECH USA, INC.、ACCRETECH (EUROPE) GmbH

従来連結子会社であった(株)リープルについては当連結会計年度に清算を完了しているが、清算時までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書については連結しております。

(2) 非連結子会社

(株)東精ボックス、ACCRETECH(MALAYSIA)SDN,BHD.、ACCRETECH(ISRAEL)LTD.、ACCRETECH(SINGAPORE)PTE LTD.、ACCRETECH MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO.,LTD.、東精精密設備(上海)有限公司、TOSEI(THAILAND)CO.,LTD.、東精計量儀(平湖)有限公司、TOSEI(KOREA)CO.,LTD.、三門峡中原精密有限責任公司

連結の範囲から除いた理由は、上記10社がいずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等の金額がいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。

2 . 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社については、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3 . 連結子会社の決算日に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4 . 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの.....連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しています。)

時価のないもの.....移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) たな卸資産

親会社及び国内連結子会社は、商品・製品・材料及び貯蔵品については、主として先入先出法による原価法、仕掛品については、個別法による原価法であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。

(ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

その他の無形固定資産は、定額法であります。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れの損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度より費用処理しております。

(二) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく連結会計期間末支払見込額を計上しております。なお、親会社は、当連結会計年度より役員退職慰労金制度を廃止しており、取締役分については平成 17 年 3 月末日、監査役分については平成 17 年 6 月末日時点の支払見込額をもって引当金計上額としております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。また、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。なお、在外連結子会社等の資産・負債および収益・費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

適用要件を満たしている場合は、金利スワップについては特例処理、為替予約については振当処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)	(ヘッジ対象)
金利スワップ	借入金
為替予約	外貨建金銭債権

(ハ) ヘッジ方針

金利スワップ……変動金利による調達コスト(支払利息)に及ぼす影響を回避するため、ヘッジ会計を行う方針であります。

為替予約……輸出取引に関する外貨建金銭債権について為替変動のリスクに備えるため、その残高の範囲内で為替予約取引を行うものとしております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。

(7) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

6. 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、その個別案件ごとに判断し、合理的な年数(10年)で償却しております。

7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。

8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

9 . セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

[前連結会計年度](平成16年4月1日～平成17年3月31日) (単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造 装置関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
.売上高及び営業損益					
外部顧客に対する売上高	66,669	18,081	84,750	-	84,750
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	66,669	18,081	84,750	-	84,750
営業費用	57,884	13,814	71,698	-	71,698
営業利益	8,784	4,267	13,051	-	13,051
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	80,434	18,947	99,382	1,611	100,993
減 価 償 却 費	2,404	327	2,732	-	2,732
資 本 的 支 出	2,731	1,040	3,771	-	3,771

[当連結会計年度](平成17年4月1日～平成18年3月31日) (単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造 装置関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
.売上高及び営業損益					
外部顧客に対する売上高	71,824	21,020	92,845	-	92,845
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	71,824	21,020	92,845	-	92,845
営業費用	62,852	16,000	78,853	-	78,853
営業利益	8,972	5,019	13,991	-	13,991
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	83,885	21,256	105,141	4,733	109,875
減 価 償 却 費	2,337	430	2,768	-	2,768
資 本 的 支 出	3,399	578	3,978	-	3,978

(2) 所在地別セグメント情報

[前連結会計年度](平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消 却 又は全社	連 結
. 売上高及び営業損益						
外部顧客に対する売上高	69,846	9,226	5,677	84,750	-	84,750
セグメント間の内部売上高又は振替高	9,277	-	-	9,277	(9,277)	-
計	79,123	9,226	5,677	94,027	(9,277)	84,750
営 業 費 用	66,386	9,199	5,478	81,064	(9,365)	71,698
営 業 利 益	12,737	27	199	12,963	88	13,051
. 資 産	96,292	6,052	2,363	104,708	(3,715)	100,993

[当連結会計年度](平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消 却 又は全社	連 結
. 売上高及び営業損益						
外部顧客に対する売上高	78,130	9,054	5,660	92,845	-	92,845
セグメント間の内部売上高又は振替高	9,409	-	-	9,409	(9,409)	-
計	87,539	9,054	5,660	102,254	(9,409)	92,845
営 業 費 用	74,322	8,809	5,137	88,269	(9,415)	78,853
営 業 利 益	13,217	244	523	13,985	6	13,991
. 資 産	101,349	6,468	2,940	110,758	(882)	109,875

(3) 海外売上高

[前連結会計年度](平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	25,048	8,166	5,706	3,938	42,860
. 連 結 売 上 高					84,750
. 連 結 売 上 高 に 占 め る 海 外 売 上 高	29.6%	9.6%	6.7%	4.7%	50.6%

[当連結会計年度](平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	31,224	7,043	5,034	4,374	47,676
. 連 結 売 上 高					92,845
. 連 結 売 上 高 に 占 め る 海 外 売 上 高	33.6%	7.6%	5.4%	4.7%	51.3%

10. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	前連結会計年度		当連結会計年度	
	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	前年同期比(%)	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	前年同期比(%)
半導体製造装置	67,708	+ 41.7 %	69,441	+ 2.6 %
計測機器	18,054	+ 16.7 %	21,444	+ 18.8 %
合計	85,763	+ 35.6 %	90,886	+ 6.0 %

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

(2) 受注状況

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日		自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造装置	65,248	13,400	77,874	19,450
計測機器	18,207	3,691	21,683	4,354
合計	83,456	17,091	99,558	23,804

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

(3) 販売実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	平成16年4月1日 平成17年4月31日	前年同期比(%)	平成17年4月1日 平成18年3月31日	前年同期比(%)
半導体製造装置	66,669	+ 41.7 %	71,824	+ 7.7 %
計測機器	18,081	+ 18.3 %	21,020	+ 16.3 %
合計	84,750	+ 36.0 %	92,845	+ 9.6 %

(注) 金額表示は消費税抜きであります。

1 1 . 有価証券の時価等

〔前連結会計年度〕(平成 17 年 3 月 31 日現在)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	取得原価	連結貸借対照表計上額	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株 式	939	1,320	380
そ の 他	-	-	-
小 計	939	1,320	380
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株 式	1,651	1,395	255
そ の 他	-	-	-
小 計	1,651	1,395	255
合 計	2,591	2,715	124

(2) 時価評価されていない有価証券 (単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	808
そ の 他	-
合 計	808

〔当連結会計年度〕(平成 18 年 3 月 31 日現在)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	取得原価	連結貸借対照表計上額	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株 式	2,764	5,027	2,262
そ の 他	-	-	-
小 計	2,764	5,027	2,262
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株 式	72	70	1
そ の 他	-	-	-
小 計	72	70	1
合 計	2,836	5,097	2,260

(2) 時価評価されていない有価証券 (単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	689
そ の 他	-
合 計	689

12. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、総合設立の厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。国内連結子会社は、退職一時金制度と一部適格退職年金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

	(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)	
	前連結会計年度 平成 17 年 3 月 31 日現在	当連結会計年度 平成 18 年 3 月 31 日現在
イ.退職給付債務	7,516	7,409
ロ.年金資産(退職給付信託分を含む)	3,104	5,599
ハ.退職給付引当金	3,610	3,822
差引(イ-ロ-ハ)	801	2,012
(差引分内訳)		
ニ.未認識数理差異の未処理額	801	2,012

(3) 退職給付費用に関する事項

	(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)	
	前連結会計年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日	当連結会計年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日
イ.勤務費用	381	382
ロ.利息費用	134	132
ハ.期待運用収益	15	14
ニ.数理計算上の差異の費用処理額	231	169
ホ.退職給付費用(イ+ロ-ハ+ニ)	731	668

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前連結会計年度 期間定額基準	当連結会計年度 期間定額基準
イ.退職給付見込額の期間配分方法		
ロ.割引率	2.0 %	2.0 %
ハ.期待運用収益率	2.5 %	2.5 %
ニ.数理計算上の差異の処理年数	10 年	10 年

13. 関連当事者との取引

該当事項はありません。